

2026年5月20日  
センクシア株式会社

～パネル部鋼管と上階柱の板厚拡大が可能に～

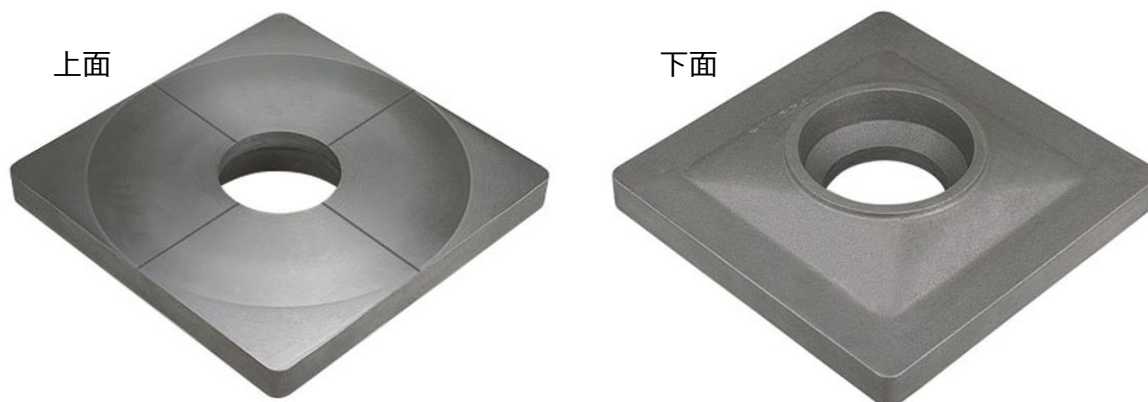
### 柱絞り通しダイアフラム「スマートダイア®Ⅱ工法」シリーズから鋳鋼品を新発売

建材機器の製造・販売及び施工を手がけるセンクシア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雄一）は、柱絞り通しダイアフラム「スマートダイアⅡ工法」シリーズにおいて、新たに鋳鋼タイプ（SDC 型式）をラインナップしました。

スマートダイアⅡ工法は、パネルゾーンにテーパコラムを用いることなく、下階柱より上階柱のサイズを絞ることができる通しダイアフラム工法として、設計・製作の合理化に貢献してきました。一方で、柱板厚を拡大する必要がある一部の設計条件においては、スマートダイアⅡ工法の適用範囲外となるケースもありました。

今回、**鋳鋼タイプ（SDC 型式）のラインナップで適用柱板厚を拡大**したことで、スマートダイアⅡ工法の適用範囲を広げ、より幅広い設計条件に対応できるようになりました。

これにより、**柱板厚条件への対応が求められる設計においても、スマートダイアⅡ工法を選択肢として検討しやすくなります。**



スマートダイアⅡ工法 鋳鋼タイプ（SDC 型式）

本工法を用いた柱はり接合部の性能および施工方法については、（一財）日本建築センターの評定を取得しています。また、通しダイアフラムとして必要な板厚方向の性能を有する国土交通大臣認定取得材を採用しています。

スマートダイアⅡ工法は、絞りを最大 150mm まで拡大するとともに、ブレースおよび高強度鋼にも対応可能なラインナップを展開しています。

今回、鑄鋼タイプ（SDC 型式）による適用柱板厚の拡大を加えたことで、設計者およびファブリケーターの皆さまにとって、スマートダイアⅡ工法はさらなる汎用性を備えたシリーズとなりました。今後もスマートダイアⅡ工法は、設計条件の多様化に対応するラインナップの拡充を通じて、設計・製作の合理化に貢献していきます。

## 【商品概要】

- 商品名：スマートダイア®Ⅱ工法
  - 型式：SDC 型式（鑄鋼タイプ）
  - 適用下階柱サイズ：□600、□650、□700、□750、□800
  - 適用柱板厚：最大 40mm（パネル部鋼管、上階柱）
  - 材質：HCW490B（国土交通大臣認定取得材：MSTL-0636）
  - 基準強度：325N/mm<sup>2</sup>以下の柱材に適用可能
  - 販売開始：2026 年 5 月
- ・本商品は受注生産品です。ご採用の際はセンクシアまでお問い合わせください

●本件に関するお客様のお問い合わせ先

センクシア株式会社 デバイス事業部

TEL：03-4214-1928

●本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先

センクシア株式会社 経営戦略部 広報・マーケティンググループ

TEL：03-4214-1966 / E-mail：keiki@senqcia.com